

9. PCB-Designer-Tag

5G - 3x High

Cutting-Edge Design: HDI, High Speed, High Power

Termin: 28.05.2019

Ort: **WITTENSTEIN SE**
Walter-Wittenstein-Straße 1
97999 Igersheim - Harthausen

08:30 – 09:00 Uhr **Registrierung**

09:00 – 09:10 Uhr **Begrüßung**

NN, WITTENSTEIN SE
Prof. Dr. Rainer Thüringer, FED-Vorstandsvorsitzender

09:10 – 09:55 Uhr **Technology evolution towards 5G**
Referent: Thomas Randt, Telit

09:55 – 10:30 Uhr **Kaffeepause & Networking**

10:30 – 11:00 Uhr **Smarte Produkte, Data Driven Services und Industrial Intelligence**
Referent: Bernd Vojanec, WITTENSTEIN SE

11:00 – 12:00 Uhr **1. Workshop – High-Density-Interconnect und High-Speed**
Einführungsvortrag zu HDI & High-Speed (30 Minuten)
Workshop zu Layout-Lösungen für die kompakten und komplexen Baugruppen von heute und morgen (30 Minuten)
Referent: Michael Schwitzer, Ciboard electronic GmbH



- 12:00 – 13:15 Uhr **Mittagspause & Networking**
- 13:15 – 14:15 Uhr **2. Workshop – High-Power-Baugruppen-Design**
Einführungsvortrag zu High Power (30 Minuten)
Workshop zu High-Power-Umsetzung auf der Leiterplatte (30 Minuten)
Referent: Michael Schleicher, SEMIKRON Elektronik GmbH & Co. KG
- 14:15 – 14:45 Uhr **Kaffeepause & Networking**
- 14:45 – 16:15 Uhr **Firmenrundgang bei WITTENSTEIN SE**
Innovationsfabrik und Teile der Produktion
- 16:15 – 16:30 Uhr **Abschlussrunde/ Verabschiedung**
- 16:30 Uhr **Ende der Veranstaltung**

Moderation der Workshops: Prof. Dr. Rainer Thüringer, FED

